

NIKAFLEX®

ハロゲンフリー接着剤(半硬化)シート
(Semicured) Halogen free Adhesive Sheet

SA-series

型式
Model

SA FN

特徴 Characteristics

- **接着強度に優れる**
Excellent bonding strength
- **常温保管が可能です (20℃)**
Normal temperature storage is possible.(20℃)
- **電気特性に優れる**
Excellent in insulation resistance
- **ハロゲン、アンチモン、リンフリー材料です**
SA FN doesn't contain halogen, antimony and phoshorus

標準製品仕様

Specifications of standard Products

接着剤 Adhesive	種類 Classification	熱硬化性樹脂 Thermosetting Resin
	厚さ (μm) Thickness	25
接着剤面の保護材 Releasing Material on Adhesive Surface	剥離フィルム Release Film	
	剥離紙 Release Paper	
標準サイズ (mm) Standard size	500×Roll (100m)	

構成 Composition

剥離フィルム Release Film

SA FN

剥離紙 Release Paper

使用上の注意点 Caution

- 1 接着剤は半硬化となっておりますので、常温で放置しておきますと接着剤の硬化が急速に進行致しますので、保管は低温(3～20℃以下)、湿度80%以下で管理して下さい。
Time and temperature rapidly promote a change from the semicured to the fully cured adhesive state, so keep SA FN at 3~20℃ or below and at 80%RH or below.
- 2 納入後の保証期間
製品の保証期間は納入後6カ月です。但しその間の保管条件20℃以下とします。
Term of Guarantee for Product
The term of guarantee for the products shall be 6 months deliver products that the products are stored at 20℃ or low.

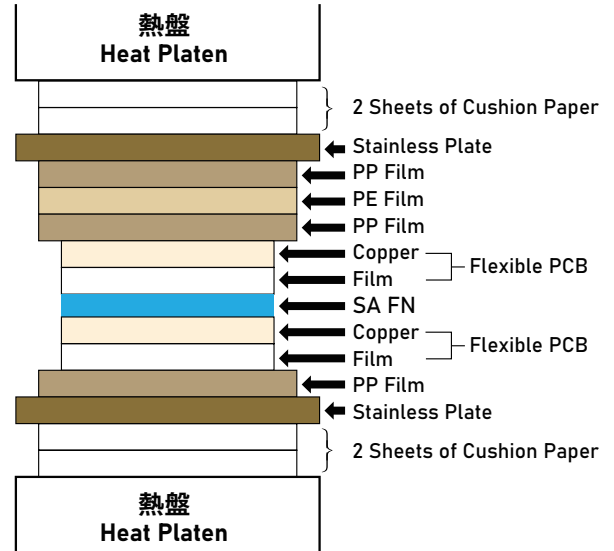
加工方法例

An Example of Processing Method

プレス手順 Procedures (Press-Bonding)

- 1 常温セット
Setting at room temp.
- 2 エアー抜き 3 回程度
Removing Air (about 3 times)
- 3 圧カセット(4MPa)
Apply pressure (4 MPa)
- 4 温度上昇
Temp. Elevation
- 5 100℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 100°C
- 6 圧カセット(4MPa)
Apply pressure (4 MPa)
- 7 140~160℃位になった時点で再度エアー抜き
Removing Air again at 140 to 160°C
- 8 160℃、4MPa、60分セット
Press-bonding at 160°C under pressure of 4MPa for 60 min.
- 9 冷却
Cooling
- 10 取出し
Taking out

プレスセット例 Materials assembly for Press-bonding



性能例

Characteristic

試験項目 Test item	単位 Unit	処理条件 Treatment conditions	標準値 (平均) Standard Value	保証値 (平均) Guaranteed Value	試験方法 Test Method
接着剤フロー Resin Flow	mm	A	0.12	0.2 以下 (Max.)	弊社方式 Our Standard
引きはがし強さ Peel Strength	N/mm	A	1.7	0.5 以上 (Min.)	弊社方式 Our Standard
はんだ耐熱性 Solder Heat Resistance	—	288°C/10sec.	異常なし No Change in Appearance	ふくれ、或いははがれが生じてはならない No Delamination and Blister	IPC-FC-232B

- NOTE
- (1) 引きはがし強さ、はんだ耐熱性についてはポリイミドフィルム 50 μ m と FR-4 を SA FN25 でプレスにより貼り合わせた時の値です。
Values of peel strength and solder heat resistance are those of laminate using SA FN25 as adhesive in press-bonding the untreated side of polyimide film (50 μ m,) with unclad FR-4 .
 - (2) 接着剤フローについてはポリイミドフィルム 50 μ m と、FR-4 を SA FN25 でプレスにより貼り合わせた時の値です。
Value of Resin Flow is that of laminate using SA FN25 as adhesive in press-bonding polyimide film (50 μ m) with unclad FR-4.
 - (3) プレス条件/温度：160℃、時間：60分、成形圧力：4MPa
Press conditions: 160°C/60min./molding pressure 4MPa